

上海市科学技术委员会

沪科提会复〔2023〕80号

对市政协十四届一次会议 第 0060 号提案的会办意见

市经济信息化委：

方奇钟委员提出的“关于规划建设上海芯片特区，提升应对国际芯片霸权能力的建议”提案收悉，经研究，现将会办意见函告如下：

集成电路是事关国家安全和国民经济发展的战略性、基础性和先导型产业，是国际竞争、大国博弈的热点和焦点。该建议考虑我国集成电路产业和科技创新面临严峻国际态势，分析了本市

芯片领域在产业规模、企业竞争力、产业链布局等方面的优势以及“东方芯港（临港新片区）”“一体两翼”的产业布局，提出了设立上海芯片特区在顶层设计、扶持政策、人才引进等方面的有关建议。这些分析和建议具有很强的针对性和较大的参考价值，对于进一步加快构建本市集成电路产业集群具有积极意义。

我委坚持围绕建设具有全球影响力的科技创新中心总目标，持续聚焦集成电路等高新技术领域创新发展需求，发挥区位优势，有组织的开展前沿引领技术和关键核心技术攻关。

重点推进战新项目临港化合物半导体量产线建设，一期项目建安工程总体完成，2022 年 9 月交付使用；设备采购完成率 95%，已到位设备 262 台套；累计总投资 10.927 亿元；正式员工人数 269 人。Fab 厂 4 英寸光电器件生产线和 6 英寸射频器件生产线已通线试产，已完成 InP、GaN 基光电和射频器件关键核心工艺开发，光电类首批产品监控光电二极管进入有条件试生产阶段，出货电性良率达到 95%；射频类首批产品砷化镓集成无源器件进入试生产环节。

重点围绕集成电路材料领域，2018 年和 2020 分别立项支持有临港片区优势企业开展 300nm 大硅片关键核心技术攻关和产业化应用示范。目前我市依托临港新片区产业集聚，已具备在 300mm 硅片领域所有新产品、新技术的研发迭代能力，随着产能持续释放且产品良率在产业化进程中不断取得突破，已打造成为目前国内技术最先进、市场优势最显著、产销规模最大、人才团队最具优势、产业化水平最高的 300mm 半导体硅片产业集聚区。

我委将围绕集成电路产业集群的打造，继续关注和支持我市集成电路产业集聚区，有组织的开展关键技术攻关。

以上意见供你单位统一答复代表时参考。

上海市科学技术委员会

2023 年 5 月 16 日

抄送：市政府办公厅建议提案处，市政协提案办。

上海市科委办公室

2023 年 5 月 16 日印发
